

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 计算机与网络 >> BGA封装芯片焊接系统

请输入查询关键词

科技频道

搜索

BGA封装芯片焊接系统

关键词: **芯片 焊接系统 封装**

所属年份: 2006

成果类型: 应用技术

所处阶段:

成果体现形式:

知识产权形式:

项目合作方式:

成果完成单位: 暨南大学

成果摘要:

本系统的核心技术是在焊接过程中对芯片温度的精确控制。其特点和创新之处在于: 焊接系统采取模块化结构设计, 采用计算机进行数据存储、分析、处理; 采用高速DSP芯片进行数据的采集和温度的控制, 本芯片功能强大、速度快、可以实现复杂的算法; 高效的温度控制算法保证焊接过程稳定进行; 管理软件使用全图形界面操作方式。本设备的技术、性能指标和国外的同类产品相比丝毫不逊色。与同类产品相比, 本系统具有结构简单、操作直观容易、焊接过程中温度可精确监控等特点。目前已实现的系统demo, 焊接一块芯片一般只需要3~5分钟, 操作简单, 成功率高, 完全可以满足中小型单位的生产、实验、维修的需求。

成果完成人:

[完整信息](#)

行业资讯

[新疆综合信息服务平台](#)

[准噶尔盆地天然气勘探目标评价](#)

[维哈柯俄多文种操作系统FOR ...](#)

[社会保险信息管理系统](#)

[塔里木石油勘探开发指挥部广...](#)

[四合一多功能信息管理卡MISA...](#)

[数字键盘中文输入技术的研究](#)

[软开关高效无声计算机电源](#)

[邮政报刊发行订销业务计算机...](#)

[新疆主要农作物与牧草生长发...](#)

成果交流

推荐成果

- [液压负载模拟器](#) 04-23
- [新一代空中交通服务平台、关...](#) 04-23
- [Adhoc网络中的QoS保证\(Wirel...](#) 04-23
- [电信增值网业务创意的构思与开发](#) 04-23
- [飞腾V基本图形库的研究与开发...](#) 04-23
- [ChinaNet国际\(国内\)互联的策...](#) 04-23
- [电信企业客户关系管理\(CRM\)系...](#) 04-23
- [“易点通”餐饮管理系统YDT2003](#) 04-23
- [MEMS部件设计仿真库系统](#) 04-23

Google提供的广告

>> 信息发布